



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE Pitch Contest

- » シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ
- » 国際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ
- » 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス

Organizer:



Co-Organizer:



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

IC 分野に強みを持つ台湾との協業 AIが創り出す新しいビジネス 異業種連携による共創

- » シリコンアイランドの強みを活かしてグローバル市場へ
- » 国際的なスタートアップ企業と海外からの投資を台湾へ
- » 日本スタートアップにとっても大きなビジネスチャンス

- 生成AIと半導体チップを組み合わせることによって業界全体のイノベーションを活性化
- 人材の教育、国際的な研究開発人材の育成に取り組み、豊富な人的資源を活用
- 「ヘテロジニアスインテグレーション」など異種チップ集積や先進技術を加速



- 5つの重点カテゴリで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

- ・台湾の半導体チップ設計・製造業界との連携を計画しているスタートアップ企業、学術・研究機関、個人はすべて大歓迎です。
- ・提案には、コア技術、解決する課題、ビジネスモデル、市場開拓計画などを含める必要があります。

分野1

AIコア技術とAIチップ

- ・サイバーセキュリティ
- ・量子コンピューティング
- ・デジタルエコノミー

分野2

スマートモビリティ

- ・電気自動車
- ・自動運転
- ・スマートシティ

分野3

スマートマニュファクチャリング

- ・IC 製造プロセス
- ・ロボット工学

分野4

スマートメドテック

- ・デジタルヘルス
- ・生体認証
- ・スマートモニタリング

分野5

持続可能性(サステイナビリティ)

- ・持続可能なモノづくり
- ・省エネイノベーション
- ・再生可能エネルギー



- 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

スタートアップとのコラボレーション、世界中から技術やソリューションの提案を募集

試作から生産の領域まで半導体製造に関する台湾の‘強み’を活かしたマートナートのマッチングを実現

EDA/IP/IC設計

EDA & IP
アナログ・デジタル処理回路
IC設計サービス

システムインテグレーション

SI Development Factory
モジュール・インテグレーション
ニッチ製品市場開拓



ウェーハ製造

チップ製造
ウェーハシャトルサービス
パッケージとテストの
サプライチェーン
先進パッケージ・テスト



Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

Mentors & Partners

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

產業界

arm

M31

cadence

GUCSIEMENS

iSTART

FARADAY

ANDES

CMSC

brocere

英業達
Inventec

日月光集團

PEGATRON

MEDIATEK

ememory

PSMC

tsmc

聯華電子

SYNOPSYS

廣達電腦
Quanta Computer

COMPAL

wistron

緯創資通

和碩聯合科技



Bor-Sung Liang

Senior Director, MediaTek



Brandon Wang

VP, Synopsys



Henry Lee

Former Technical Director,
Sunplus



Jason Jeng

Technical Director,
UMC



Jerome Hung

Vice President, M31



Konrad Young

Former Chief of RD
Department, TSMC



Kris Peng

President,
UMC Capital



Kevin Wei

Sr. Business Development,
Synopsys



Ken Li

Formal President, Rafael
Microelectronics



Louis Lin

Senior Vice President,
GUC



Michel Chu

President,
ITIC



S. Z. Chang

Vice President & CTO,
PSMC



Todd Lin

COO,
EgisTec



Tsun-Jen Hou

Former RD Director,
Faraday



Tsung-Ching Wu

Co-founder and Executive
of Vice President, Atmel



Weining Shen

Partner,
MediaTek Capital

アクセラレータ

比翼加速器
BE Accelerator

MOSAIC

新創101
STARTUP101

FLYING VEST VENTURES

IAPS

SparkLabs
TAIWAN

FOODLAND 扶田
VENTURES 資本

ORBIT
STARTUPS

TTA
TAIWAN
TECH
ARENA

TCA
台北市電腦公會
TAIPEI COMPUTER ASSOCIATION

TSIA
台灣半導體產業協會
Taiwan Semiconductor Industry Association

semi
國際半導體產業協會

業界団体

研究開発機関

大学

TSRI
NAR Labs 國家實驗研究院
台灣半導體研究中心
Taiwan Semiconductor Research Institute

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

NCHC
國家高速網路與計算中心
National Center for High-performance Computing

產學創新研究學院
I A I S 產研交流

CoSA

STT
國立中山大學
半導體及重點科技研究學院
Chuan-Shan University Graduate School of Advanced Technology

國立臺灣大學 重點科技研究學院
Graduate School of Advanced Technology

智慧半導體及永續製造學院
Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



US \$30,000



半導体業界の専門家による
ハンズオン支援



プロトタイプから製造まで
(EDAツール、ウェーハなど)



成功を確実にする
多面的なリソースとサービス



- 2026 COMPUTEX/InnoVEXへの出展
- チームが台湾に到着してから支給

- 台湾のスタートアップエコシステムの主要関係者が、受賞者を支援するためのリソースを提供し、台湾での円滑な事業立ち上げを実現します。

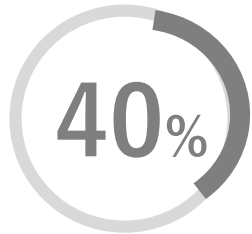


- 5つの重点カテゴリーで革新的なIC設計や先進的なソリューション及びアプリケーションを募集
- 応募はエントリーシートに、コア技術、解決可能な対象課題、ビジネスモデル、市場開拓プランなどを明記の上、ウェブサイトからお申し込みください。
- 応募条件や審査方法など詳細はウェブサイトをご覧ください。

Taiwan CbI

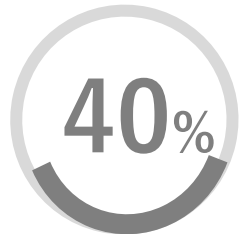
Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



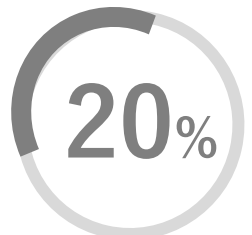
≫ 台湾で活用できるソリューションであること

台湾にニーズとマッチし、具体的な展開計画がある
台湾の産業にさらに幅広い展開の可能性をもたらす



≫ 新しい価値を創造するソリューションであること

技術革新を推進し、社会貢献できる
新しい新たな産業連携に貢献する、または産業のアップグレードを可能にする
資金調達や高い経済価値の創出を可能にする



≫ 革新的な技術を有していること

新興分野におけるイノベーションを保有
製造プロセス、設計、新素材の使用におけるイノベーションを推進
多様なイノベーションとクロスドメインの知識を統合

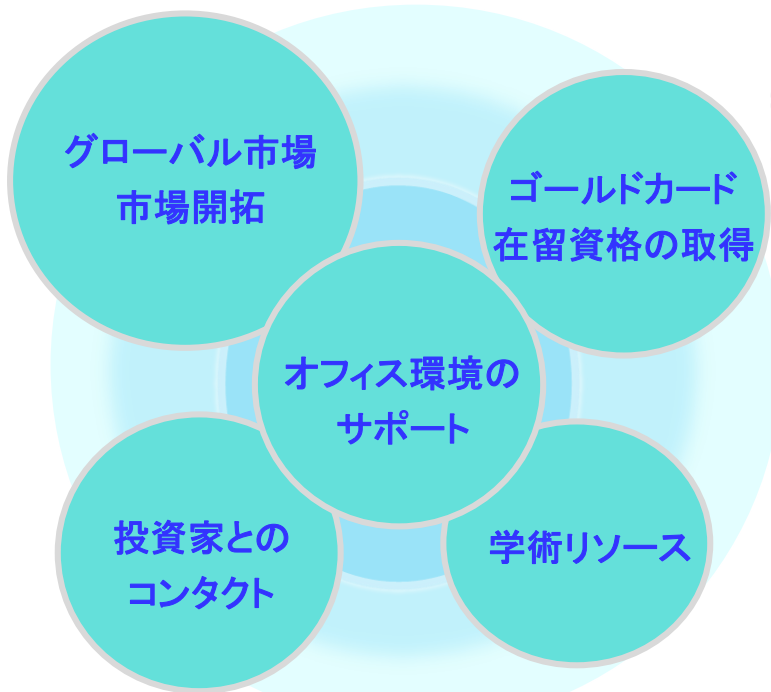


ピッチコンテスト審査基準

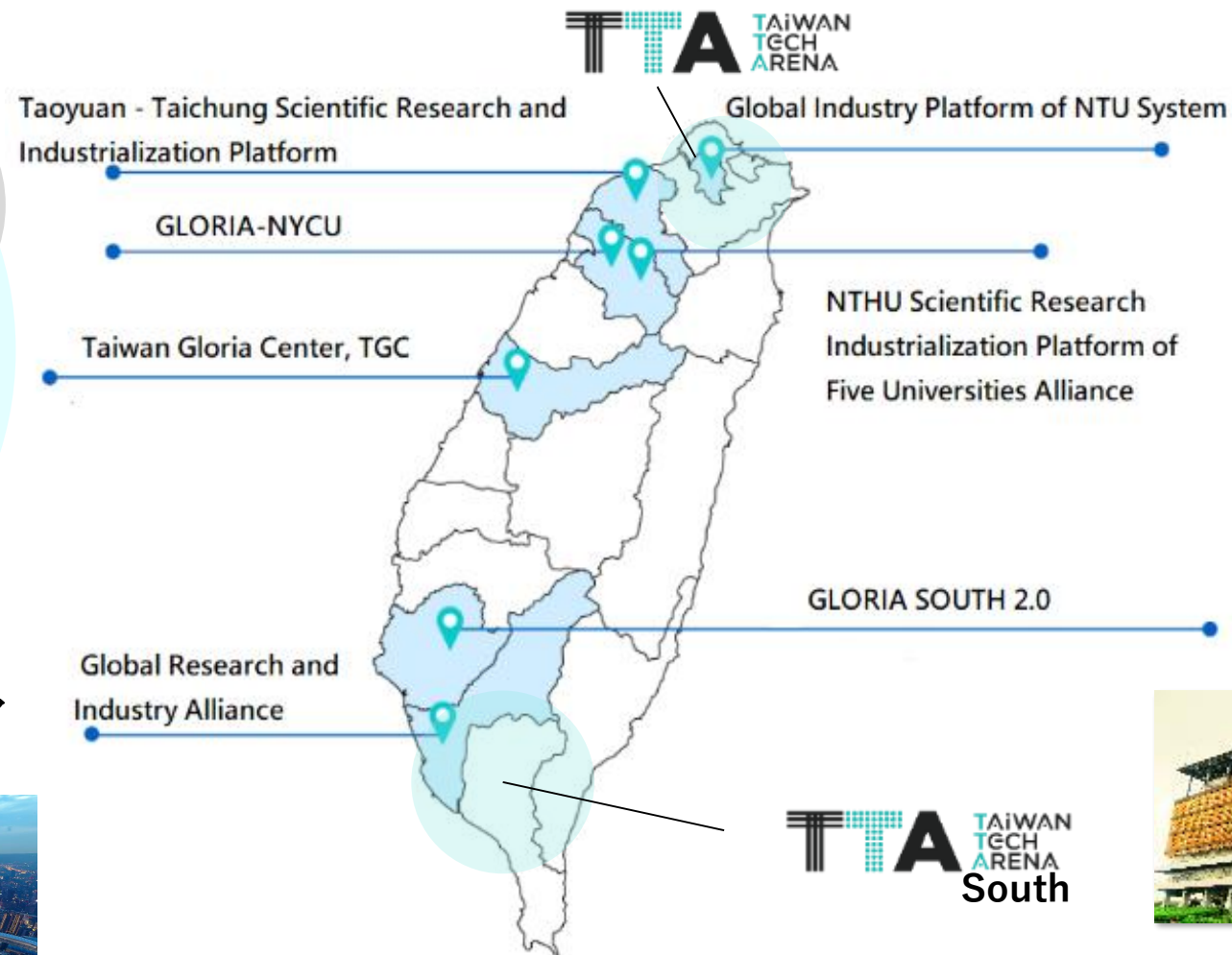
Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE



グローバル市場へのゲートウェイ



Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」

IC TAIWAN GRAND CHALLENGE

2025年11月1日
受付開始



2026年2月28日
締め切り

COMPUTEX & InnoVEX2026
受賞チームは6/2～6/5に台北で開催
される展示会COMPUTEX & InnoVEX
に出展資格が与えられます

申し込み受け付け期間

2025年11月より2026年3月まで

書類審査・オンラインプレゼン



ピッチコンテストスケジュール

Taiwan CbI

Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
台湾半導体産業強化プロジェクト「晶創台湾」



IC TAIWAN GRAND CHALLENGE Pitch Contest

<https://ictaiwanchallenge.org>

Contact Us



Mr. Jacky Chen
jacky_chen@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 940

Ms. Ariel Liu
ariel_liu@mail.tca.org.tw
+886 2 25774249 Ext. 825

Organizer:



Co-Organizer:

